



Dry Polishing Wheels

DP08SERIES

不使用化学药品亦可去除残余应力的干式抛光轮

该产品不仅适用于一般的晶圆研磨，亦适用于DBG技术，不使用化学药品也可去除残余应力

DP08系列利用迪思科公司独立开发的干式抛光技术，可以对超薄晶圆进行研磨。无需使用化学药品，因此对环境负荷小，而且与使用研磨液（膏）相比，操作更容易，实现了高抗折强度的芯片。

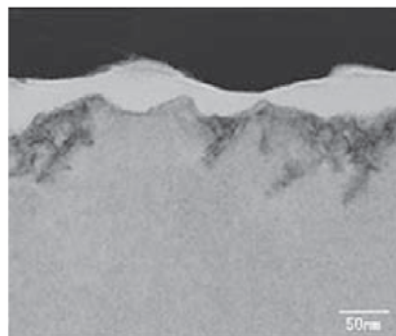


研磨损伤比较 (TEM观察)

经过干式抛光加工后，可除去晶圆中的研磨损伤。



DP08抛光后



#2000研磨后

加工对象

矽晶圆、其他材料

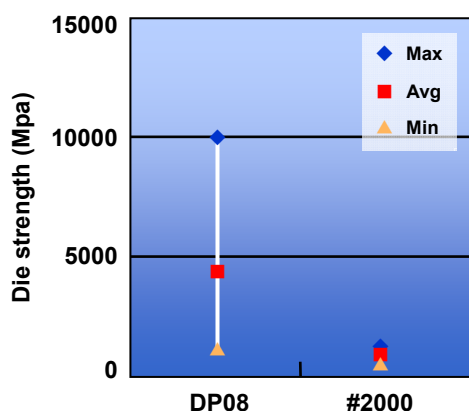
技术规格

DP08 - BC0101 450 × 11T × 150

品种 外径 厚度 内径

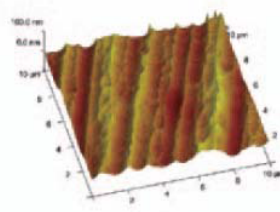
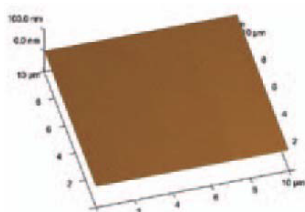
实验结果

抗折强度 (球压式抗折强度测量法)



工作物 : Φ8" 矽晶圆
最终加工厚度 : 200 μm

表面粗糙度



使用ホイール	DP08	Grinding wheel (#2000)
Ra (μm)	0.0003	0.0150
Ry (μm)	0.0017	0.0800

本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时, 请用户将产品的名称、外径、研磨磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时, 本公司销售窗口会根据不同加工要求, 协助用户选择适合的产品。届时请一并提供研磨材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。
· 为了改进产品, 本公司可能在未通知用户的情况下, 就对产品规格进行变更, 因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研磨磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害, 请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板(包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时, 请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时, 请遵照设备(装置)使用说明书的规定, 正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落在地上, 或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查, 如果有缺口或其它破损, 请停止使用。
- 在开始使用前, 请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研磨、切割及切削作业以外, 请不要使用在其它用途。
- 在使用湿式研磨、切割用精密加工刀具时, 请使用冷却液。